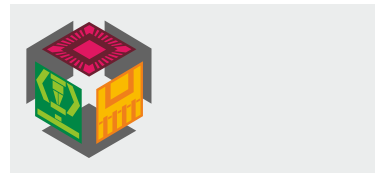


smthybridpackaging



Internationale Fachmesse und Kongress
für Systemintegration in der Mikroelektronik

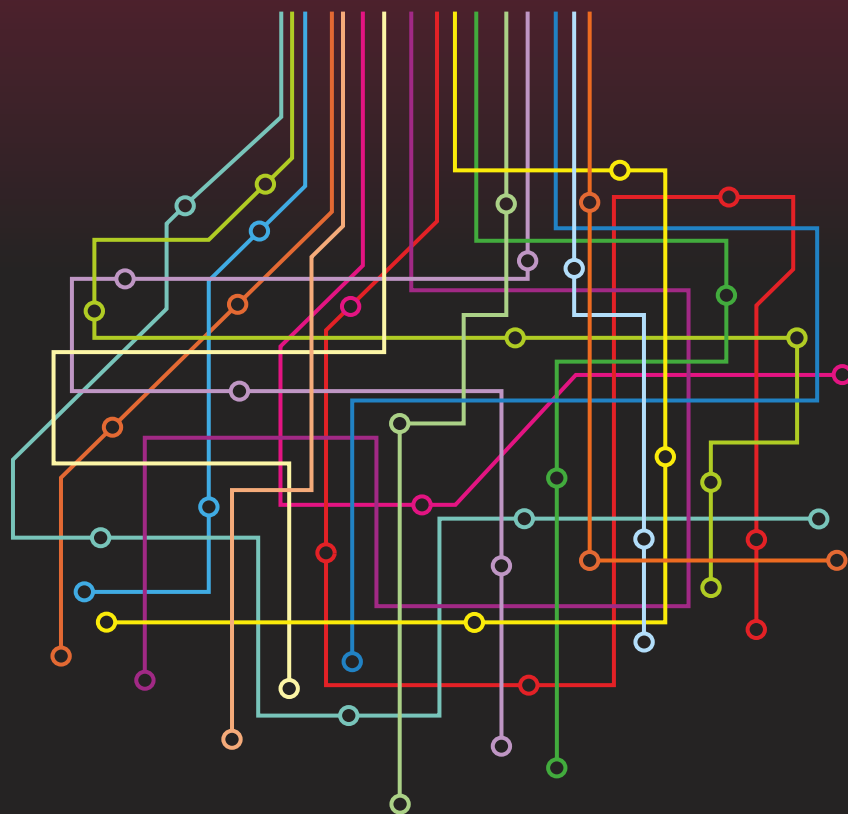
International Exhibition and Conference
for System Integration in Micro Electronics

Nürnberg, 16. - 18.04.2013

Nuremberg, 16 - 18 April 2013

Messeforum

Exhibition Forum





Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen 2013 *Panel Discussions and Vendor Presentations 2013*

Podiumsdiskussionen, Halle 9, Stand 9-340 *Panel Discussions, hall 9, booth 9-340*

Dienstag, 16.04.2013	<i>Tuesday, 16 April 2013</i>	Seite 3	<i>Page 3</i>
Mittwoch, 17.04.2013	<i>Wednesday, 17 April 2013</i>	Seite 4	<i>Page 4</i>
Donnerstag, 18.04.2013	<i>Thursday, 18 April 2013</i>	Seite 4	<i>Page 4</i>

Forum 3-D MID e.V., Halle 7, Stand 7-604 *Vendor Presentations, hall 7, booth 7-604*

Dienstag, 16.04.2013	<i>Tuesday, 16 April 2013</i>	Seite 5	<i>Page 5</i>
Mittwoch, 17.04.2013	<i>Wednesday, 17 April 2013</i>	Seite 5	<i>Page 5</i>
Donnerstag, 18.04.2013	<i>Thursday, 18 April 2013</i>	Seite 5	<i>Page 5</i>

Produktpräsentationen, Halle 9, Stand 9-424 *Vendor Presentations, hall 9, booth 9-424*

Dienstag, 16.04.2013	<i>Tuesday, 16 April 2013</i>	Seite 6	<i>Page 6</i>
Mittwoch, 17.04.2013	<i>Wednesday, 17 April 2013</i>	Seite 7	<i>Page 7</i>

Diskussionsforum ZVEI, Halle 9, Stand 9-424 *Diskussion Forum ZVEI, hall 9, booth 9-424*

Donnerstag, 18.04.2013	<i>Thursday, 18 April 2013</i>	Seite 8	<i>Page 8</i>
------------------------	--------------------------------	---------	---------------



Podiumsdiskussionen Halle 9, Stand 9-340 Panel Discussions hall 9, booth 9-340

Dienstag, 16.04.2013 *Tuesday, 16 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
11:00 - 12:00	Gemeinschaftsstand „Optics meets Electronics“		
11:00 - 11:15	MSG Lithoglas	Dr. Ulli Hanssen	Hermetic packaging using borosilicate glass
11:15 - 11:30	CSEM	Dr. Matthias Krieger	Advanced optoelectronic packaging for demanding high power laser applications, including small series production
11:30 - 11:45	Fraunhofer IZM	Dr. Henning Schröder	Mikrooptisches Assembly
11:45 - 12:00	Proaut Technology GmbH	Peter Schueßler	Handling von Kleinstteilen
12:00 - 13:00	beratungsgruppe wirth + partner	Uta Seelig	Bewerben - mit Erfolg
14:00 - 15:00	Fraunhofer IZM	Dipl. Phys. C. Kallmayer Dipl. Phys. Erik Jung	Fertigungslinie Future Packaging 2013 - LED- und Leistungsbaugruppen flexibel fertigen
15:00 - 16:00	Bundesverband der Fördermittelberater	Prof. Klaus Weiler	Chance 2013 für den Mittelstand - Finanzierung mit öffentlichen Mitteln
16:00 - 17:00	Bundesverband Six Sigma e.V.	Prof. Dr. Erhard Petzel	Six Sigma in der Elektronikfertigung - Erfahrungen und Perspektiven



Podiumsdiskussionen Halle 9, Stand 9-340 Panel Discussions hall 9, booth 9-340

Mittwoch, 17.04.2013 *Wednesday, 17 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10:00 - 11:00	Gemeinschaftsstand „Optics meets Electronics“		
10:00 - 10:15	MSG Lithoglas	Dr. Ulli Hanssen	Hermetic packaging using borosilicate glass
10:15 - 10:30	CSEM	Dr. Matthias Krieger	Advanced optoelectronic packaging for demanding high power laser applications, including small series production
10:30 - 10:45	Fraunhofer IZM	Dr. Henning Schröder	Dünnglas für elektro-optische Integration
10:45 - 11:00	Proaut Technology GmbH	Peter Schueßler	Handling von Kleinstteilen
11:00 - 12:00	Hüthig Verlag	Marisa Robles Consée	Conformal Coating in der elektronischen Baugruppenfertigung
13:00 - 14:00	Standard-Reflowlötten für Anwendungen bis 300°C – ein Widerspruch? Vorstellung des BMBF-Verbundprojektes HotPowCon		
	Robert Bosch GmbH	Dr. Andreas Fix	
	Universität Rostock	Prof. Mathias Nowotnick	
	Heraeus Materials Technology GmbH & Co.KG	Jörg Trodler	
	Siemens AG	Klaus Wilke	
	SEHO Systems GmbH	Rolf L. Diehm	
14:00 - 15:00	Fraunhofer IZM	Dipl. Phys. C. Kallmayer Dipl. Phys. Erik Jung	Fertigungslinie Future Packaging 2013 - LED- und Leistungsbaugruppen flexibel fertigen
15:00 - 16:00	AVT für Leistungselektronikmodule der Zukunft Vorstellung des BMBF-Verbundprojektes ProPower		
	Siemens AG	Prof. Hans-Jürgen Albrecht	
	Infineon Technologies AG	Dr. Markus Thoben	
	OSRAM GmbH	Dr. Michael Höge	
	Robert Bosch GmbH	Dr. Martin Rittner	

Donnerstag, 18.04.2013 *Thursday, 18 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
13:00 - 14:00	Fraunhofer IZM	Dipl. Phys. C. Kallmayer Dipl. Phys. Erik Jung	Fertigungslinie Future Packaging 2013 - LED- und Leistungsbaugruppen flexibel fertigen



Forum 3-D MID e.V. Halle 7, Stand 7-604
Forum 3-D MID e.V. hall 7, booth 7-604

Dienstag, 16.04.2013 *Tuesday, 16 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10:00 - 10:30	LPKF Laser & Electronics AG	Stephan Krause	Markt und Einsatzpotentiale der LDS-Technologie
10:30 - 11:00	2E mechatronic GmbH & Co. KG	Dr. Andreas Pajtinger	Realisierung innovativer MID Serienprodukte - MID Technologie als Bindeglied zwischen verschiedenen Funktionen und Technologien
12:00 - 12:30	PLEXPART GmbH	Thomas Mann	Entwicklung eines Werkzeugs zur Herstellung eines dreidimensionalen Schaltungsträgers aus Kunststoff
12:30 - 13:00	FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg	René Schramm	Die Potenziale der MID-Technik – Der MIDster
14:00 - 14:30	Evonik Industries AG	Volker Strohm	Thermoplastische Substratwerkstoffe für die LDS-Technologie: Form- und dimensionsstabil, hochtemperaturbeständig
14:30 - 15:00	LKT, Universität Erlangen-Nürnberg	Florian Ranft	Entwicklung neuartiger Hochleistungs-LED-Systeme auf Basis wärmeleitender Kunststoffe

Mittwoch, 17.04.2013 *Wednesday, 17 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10:00 - 10:30	LPKF Laser & Electronics AG	Sebastian Sparrer	Maschinenteknik für den LDS-Prozess
10:30 - 11:00	XENON Automatisierungstechnik GmbH	Andre Bandowski	Flexible vollautomatisierte 3D MID Montagelinien
12:00 - 12:30	MID-TRONIC Wiesauplast GmbH	Karl Görmiller	Foltronic – Decor meets Electronics: Räumliche Funktionsfolien
12:30 - 13:00	Viscom AG	Michael Mügge	AOI-Inspektion von 3D-MID
14:00 - 14:30	Lüberg Elektronik GmbH & Co. Rothfischer KG	Stefan Glöde	Selektive Kunststoffmetallisierung mittels Primertechnologie
14:30 - 15:00	MacDermid Inc.	Judy Ding	Beyond the Mold - Innovative MID Plating Solutions
16:00 - 17:00	Feierliche Verleihung des MID-Industriepreises 2013 <i>Awarding ceremony of the MID-Industry Award 2013</i>		

Donnerstag, 18.04.2013 *Thursday, 18 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10:00 - 10:30	LPKF Laser & Electronics AG	Lars Führmann	ProtoPaint und ProtoPlate LDS - Möglichkeiten zur Herstellung von MID-Prototypen
10:30 - 11:00	HARTING AG Mitronics	Michael Grätz	Neue Basismaterialien - Materialerprobung für 3D-MID-Komponenten
12:00 - 12:30	Häcker Automation GmbH	Uwe Schulz	Fortschritte in der 3D Aufbau und Verbindungstechnik
12:30 - 13:00	HSG-IMAT	Dr. Ulrich Keßler	3D-Mikromontage auf räumlichen Schaltungsträgern



Produktpräsentation Halle 9, Stand 9-424
Vendor Presentations hall 9, booth 9-424

Dienstag, 16.04.2013 *Tuesday, 16 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10.00 - 10.20	Heicks Industrieelektronik GmbH	Rudolf Heicks	Parylene – Wir machen Elektronik sicherer
10:20 - 10:40	RG Elektrotechnologie GmbH	Ulf Ahrendt	Leiterplattenreinigung mit ADC-Technologie
10:40 - 11:00	abp Automationssysteme GmbH	Raphael Podgurski	Moderne Material Logistik Kosten sparen durch ein automatisiertes Bauteil- Gebinde- Handling vom Wareneingang bis zum SMT- Automaten oder Bestückungsarbeitsplatz
11:00 - 11:20	SCHOTT ELECTRONIC PACKAGING	Robert Hettler	Customized hermetic packaging
11:40 - 12:00	DEK Printing Machines GmbH	Wigand Poertner	Vector Guard High Tension
12:00 - 12:20	GÖPEL electronic GmbH	Dr. Jörg Schambach	3D-Lotpasteninspektion - Fehlererkennung mit Zusatzpotential
12:20 - 12:40	Schoeller-Electronics GmbH	Markus Wille	Innovative Methoden zur Wärmeableitung in Leiterplatten
12:40 - 13:00	Retronix Ltd.	Tony Boswell	How to desolder ICs from PCBs safely for re-use, reducing environmental impact and reducing scrap costs
13:00 - 13:20	Microelectronic Packaging Dresden GmbH	Thomas Ruf	Advanced Packaging – Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Sensoren
13:20 - 13:40	ZESTRON Europe	Dr. Helmut Schweigart	Automatische inline Badüberwachung - Tracken Sie Ihren Reinigungsprozess in Echtzeit!
13:40 - 14:00	HOTOPRINT Elektronik GmbH & Co. KG	Antonios Bouzakis / Nils Tolle	RFID PCB - integrated solution for identification, serialisation , traceability and anti counterfeit
14:00 - 14:20	DYCONEX AG	Daniel Schulze	Ultra-HDI FPC Demonstrator
14:20 - 14:40	Dr. Hönle AG	Ulrich Karbaum	Perfekte Aushärtung von High-Tech-Klebstoffen und Vergussmassen mit UV-/UV-LED Aushärtegeräten der Dr. Hönle AG
14:40 - 15:00	TAIPRO Engineering SA	Michel Saint-Mard	Innovative smart sensors & microelectronic assembly challenges
15:00 - 15:20	Indium Corporation of Europe	Wolfgang Bloching	Engineered Solder Preforms & Unique Flux Chemistries to maximize the SMT process window
15:20 - 15:40	DEK Printing Machines GmbH	Jens Katschke	Brennstoffzellentechnik
15:40 - 16:00	Teradyne Inc.	John Arena	Doing more with a lot less: Automatization and multi-site PCB test economics



Produktpräsentation Halle 9, Stand 9-424
Vendor Presentations hall 9, booth 9-424

Mittwoch, 17.04.2013 *Wednesday, 17 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10.00 - 10.20	Totech GmbH	Raphael Podgurski	Neue Konzepte und Lösungen für eine moderne Lagerlogistik elektronischer Bauelemente und Komponenten in der Elektronik-Industrie
10:20 - 10:40	TechnoLab GmbH	Kris Karbinski	Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der optischen Inspektion
10:40 - 11:00	Ferro Electronic Material System	David Merricks	New Ferro Polymer Pastes for Printed Electronics Applications
11:00 - 11:20	GÖPEL electronic GmbH	Jens Kokott	Effektive THT-Lötstellen- und Bauteilinspektion mit modularem AOI-Systemkonzept
11:40 - 12:00	SmartRep GmbH	Sebastian Aulbach	Schutzlackierung von Baugruppen mit SCS Precisioncoat
12:00 - 12:20	InterSelect GmbH	Benjamin Lorreck	The new generation of selective soldering machines
12:20 - 12:40	FELDER GMBH	Udo Grimmer-Herklotz	Neue Generation bleifreier Weichlötdrähte
12:40 - 13:00	Siegert TFT GmbH	Norbert Heinrich	Präzisionswiderstände und Netzwerke für hohe Einsatztemperaturen bis 260°C
13:00 - 13:20	MODI Modular Digits GmbH	Dieter Klawunder	Umlabelprozess im Wareneingang
13:20 - 13:40	INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co. KG	Maximilian Meindl	Kostenersparnis zur Eigenerzeugung von Stickstoff
13:40 - 14:00	Router Solutions GmbH	Kevin Decker-Weiss	Steigern Sie Ihre Produktivität mit innovativer Technologie in der Prozessplanung und mit der „just in time“ Materialsteuerung beim Bestücken von Leiterplatten
14:00 - 14:20	Bay-Soft GmbH	Dr. Bodo Dahl	Goodbye Stillstandszeiten Bay-2 MES Elektronikproduktion
14:20 - 14:40	LPKF Laser & Electronics AG	Bruno Blum	Inhouse PCB Prototyping of MIDs
14:40 - 15:00	ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH	Claus Zabel	Voidfreies Löten extremer Komponenten mittels Multivacuumtechnologie
15:20 - 15:40	Schoeller-Electronics GmbH	Uwe Braun	Bend-it/Der kostengünstige Einstieg in die Starr-flex-Technik
15:40 - 16:00	Epoxy Technology Inc. / John P. Kummer GmbH	Brian Bruce / Nicolas Schwarz	Epoxy Technology Presents Cure Matters: Determining Proper Epoxy Cure Schedule
16:00 - 16:20	DYCONEX AG	Daniel Schulze	Ultra-HDI FPC Demonstrator



Diskussionsforum ZVEI Halle 9, Stand 9-424 Discussion Forum ZVEI hall 9, booth 9-424

Donnerstag, 18.04.2013 *Thursday, 18 April 2013*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
10:00 - 11:15	Die Welt des Testens - mit Sicherheit die gewünschte Qualität ZVEI-Services in EMS Initiative. Moderation: Michael Velmeden, cms electronics GmbH		
	CCS Customer Care & Solutions Holding AG	Erich Baumgartner	
	GÖPEL electronic GmbH	Mario Berger	
	Eltroplan GmbH	Gustl Keller	
	SRI Radio Systems GmbH	Harald Kaderabek	
11:15 - 12:15	LED Licht DesignTechnik Moderation: Ralf Schwartz, Lackwerke Peters GmbH + Co KG Norbert Krütt, FELA GmbH		
	FELA GmbH	Norbert Krütt	
	Lackwerke Peters GmbH + Co KG	Torben Kokernak	
	Neumüller Elektronik GmbH	Marko Konjevic	
12:15 - 13:30	Technologieroadmap LDI (Laserdirektbelichtung) Moderation: Elke Krüger, CCI Eurolam GmbH		
	KLEO Halbleitertechnik GmbH	Stefan Scharl	
	LIMATA GmbH	Attila Heim	
	Orbotech S.A.	Uwe Altmann	
	Schmoll Maschinen GmbH	Thomas Kunz	